



全倒装COB显示面板

Mini微间距 0.7/0.9/1.2/1.5





超稳定

超高可靠性与稳定性
像素失效率小于5PPM



防磕碰

防磕碰，不掉灯



防静电

防尘、防潮、防静电



易清洁

防水耐磨，可直接擦洗
易清洁维护



高对比

超高对比度、超大视角、
模组一致性好，不反光



低功耗

共阴方案，低热量
低功耗，寿命更长

自主研发
Mini
倒装芯片

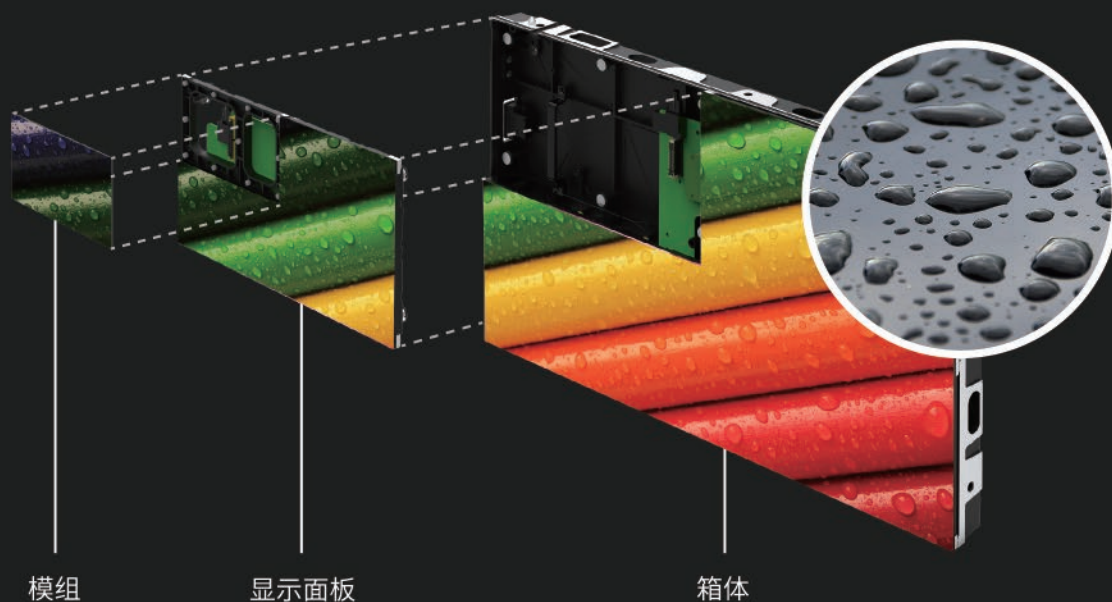
RGB
全倒装
COB封装

专利巨量
转移技术

影院级HDR



九洲光电2012年COB相关发明专利证书



超高可靠性

倒装COB产品采用全倒装发光芯片及无线线封装工艺，发光芯片直接与PCB板的焊盘键合，焊接由点到面，焊接面积增大，焊点减少，产品性能更稳定。封装层无需焊线空间，封装层更轻薄，降低热阻，提升光品质，提高显示屏寿命。超高防护性，防撞、防震、防水、防尘、防盐雾、防静电。



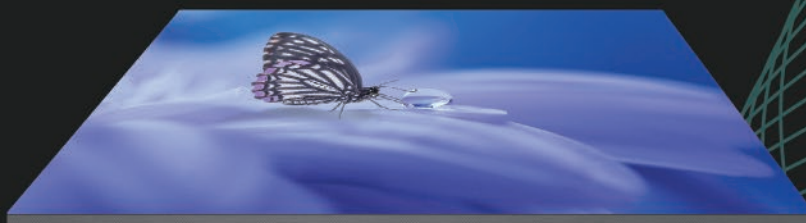
其他产品



九洲全倒装COB

显示效果更佳

28000:1超高对比度，黑场更黑、亮度更亮、对比度更高。支持HDR数字图像技术，静态及高动态画质精细完美。首创逐点一致化校正技术，可实现精准采集和精确亮度校正功能，均匀度97%以上。



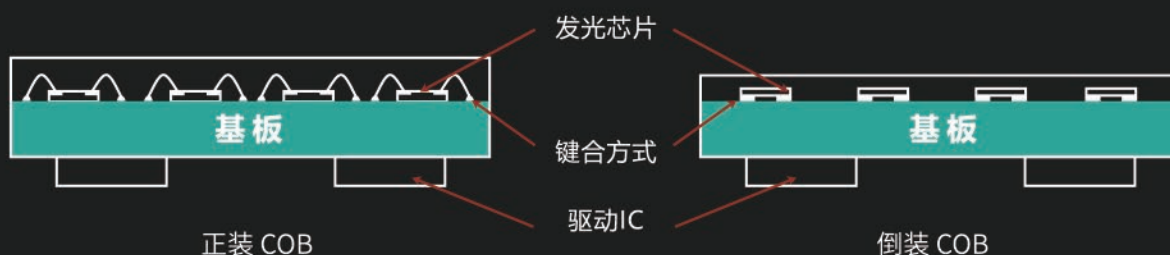
实现“点”光源到“面”光源的转换

无像素颗粒感；对像素中心亮度能够做到有效控制，降低光强辐射，抑制摩尔纹，避免眩光刺目对视网膜的伤害，适合近距离、长时间观看，不易产生视觉疲劳。



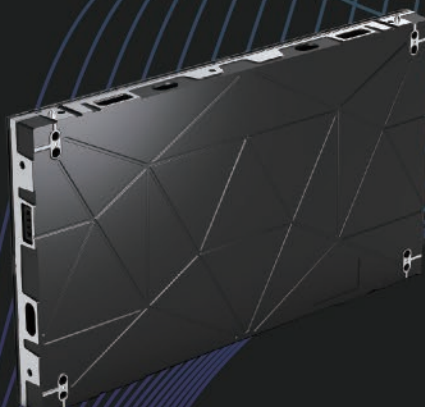
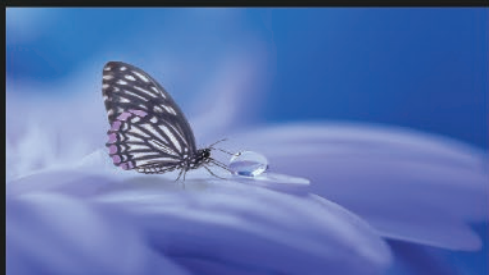
大尺寸 宽视域

2K/4K/8K分辨率无限尺寸自由拼接，适用于大场景显示。有良好的可视角度和侧视显示均匀性，大视角下不偏色，可达到170度的观看角度。



超高密度 更小点间距

倒装COB是真正的芯片级封装，无需焊线，物理空间尺寸只受发光芯片尺寸限制，突破正装芯片的点间距极限，是点间距0.8mm以下产品的首选。



独特“显示光学”特性 节能高效节能

全倒装发光芯片，同等亮度条件下，功耗降低30%。封装结构所形成的非晶面积，均可覆盖黑色吸光材料。这使得九洲倒装COB产品在对比效果上更为出色；独特低产热技术，屏体表面温度比常规显示屏降低30%，更适用于近屏体验的应用场景。

■ 产品技术参数

项目	技术规格			
像素封装方式	COB封装			
像素点构成	1R1G1B，全倒转芯片			
像素间距 (mm)	0.7	0.9	1.2	1.5
模组尺寸 (mm)	148*83.25	148*83.25	148*111	148*83.25
模组分辨率 (W×H)	192*108	160*90	120*90	96*54
显示面板尺寸 (mm)	296*166.5	296*166.5	296*111	296*166.5
显示面板分辨率 (W×H)	384*216	320*180	240*90	192*108
显示面板重量 (KG/单元)	0.738			
箱体尺寸 (mm)	592mm*333mm*50mm			
箱体重量 (KG/单元)	6.8			
像素密度 (点/m2)	1682980	1168736	657414	420745
安装/维护方式	前安装/前维护			
支持热插拨	支持			
单点亮度校正	有			
单点色度校正	有			
校正数据存储	存储在面板上			
显示面板校正亮度	400-600cd/m2			
扫描方式/扫描数	1/64	1/54	1/30	1/32
对比度	28000:1			
亮度均匀性	≥97%			
色度均匀性	±0.003Cx，Cy之内			
显示面板峰值功耗 (W/m2)	≤450			
显示面板平均功耗 (W/m2)	≤150			
供电要求 (面板)	DC3.7V			
驱动方式	动态扫描，恒流驱动			
换帧频率 (Hz)	50&60			
刷新率-最大 (Hz)	3840			
运行环境温度	-10 ~ 50℃			

*各规格具体技术参数请参考相应产品规格书



四川九洲电器集团有限责任公司
电话：0816-2471120
地址：四川省绵阳市科创园九洲大道257-259号
网址：www.jezetek.cc



深圳市九洲光电科技有限公司
电话：0755-21389888
地址：深圳市光明新区九洲工业园1-4楼
网址：www.jezetek-led.com